

2015年12月2日

## ■「R-Car H3」の主な仕様

■「R-Car H3」の主	な仕様			
項目	R-Car H3 仕様	R-Car H3 仕様		
製品名 (型名)	R-Car H3 (R8A77950(SoC), R8J77950(SiP),)			
電源電圧	3.3/1.8 V(IO), 1.10V(LPDDR4), 0.8V(core)			
CPU コア	ARM®Cortex®-A57	ARM®Cortex®-A53	ARM®Cortex®-R7	
	Quad	Quad	Dual Lock-Step 対応	
キャッシュメモリ	L1 命令キャッシュ:	L1 命令キャッシュ:	L1 命令キャッシュ:	
	48K バイト	32K バイト	32K バイト	
	L1 データキャッシュ:	L1 データキャッシュ:	L1 データキャッシュ:	
	32K バイト	32K バイト	32K バイト	
	L2 キャッシュ:	L2 キャッシュ:		
	2M バイト	512kバイト		
外部メモリ	・DDR 専用バスに LPD			
・最大動作周波数:1600MHz				
	・データバス幅:32ビット x 4 チャネル (12.8GB/s x4 チャネル)			
外部拡張	PCI エクスプレス 2.0 (1 レーン) x 2 チャネル			
3D グラフィックス	IMG PowerVR Series6XT GX6650			
ビデオ機能	ビデオ表示インタフェース x 3 チャネル			
	ビデオ入力インタフェース x 8 チャネル			
	ビデオ codec モジュール(H.265、H.264/AVC、MPEG-4、VC-1 等)			
	I/P 変換モジュール			
	TS インタフェース x 2 チャネル			
	ストリームプロセッサ			
	ビデオ画像処理機能 (リサイズ、ダイナミックガンマ補正、色空間変換、超解像、			
	回転、Lossy 圧縮、可逆データ伸張)			
	歪み補正モジュール(IMR-LSX4) 高性能リアルタイム画像認識エンジン(IMP-X5)			
オーディオ機能	オーディオ DSP			
	サンプリングレート変換 x 10 チャネル			
	サウンドシリアルインタフェース x 10 チャネル			
	MOST DTCP 暗号対応			
ストレージインタフェ	ェ USB 3.0 ホストインタフェ	USB 3.0 ホストインタフェース(DRD 対応) x 1 ポート(wPHY) USB 2.0 ホスト/ファンクション/OTG インタフェース x 2 ポート(wPHY)		
ース	USB 2.0 ホスト/ファンク			
	SD ホストインタフェース x 4 チャネル			
	マルチメディアカードインタフェース x 2 チャネル			
	PCIe/Serial ATA インタフ	フェース x 1 チャネル		
		- / 1 1/		

車載インタフェース	メディアローカルバス(MLB)インタフェース x 1チャネル(3 線式)		
	コントローラエリアネットワークインタフェース(CAN-FD 対応)× 2 チャネル		
	Ethernet AVB 1.0 対応 MAC 内蔵 インタフェース: RGMII Ethernet AVB (802.1BA)		
	• IEEE802.1BA		
	• IEEE802.1AS		
	• IEEE802.1Qav		
	• IEEE1722		
暗号処理部	暗号処理エンジン(AES、DES、ハッシュ関数、RSA)		
	SystemRAM		
主な周辺機能	SYS-DMAC x48 チャネル、Realtime-DMAC x16 チャネル		
	Audio-DMACx32 チャネル、Audio(周辺)-DMAC x29 チャネル		
	32bit タイマ x26 チャネル		
	PWM タイマ x 7 チャネル		
	I2C バスインタフェース× 7 チャネル		
	シリアルコミュニケーションインタフェース(SCIF) x 11 チャネル		
	クワッド・シリアルペリフェラルインタフェース(QSPI) x 2 チャネル(HyperFlash 対		
	応)		
	クロック同期シリアルインタフェース(MSIOF) x 4 チャネル(SPI/IIS サポート)		
	デジタルラジオインターフェース(DRIF) x 4 チャネル		
	MOST50 インタフェース		
低消費電力モード	モジュール電源遮断機能		
	AVS(Adaptive Voltage Scaling)機能、DVFS(Dynamic Voltage and Frequency Scaling)機能 及び DDR-SDRAM 電源バックアップモードをサポート		
パッケージ	1384 ピン FCBGA 0.5mm ピッチ (21mm × 21mm)		
	1255 ピン SiP モジュール 0.8mm ピッチ (42.5mm × 42.5mm)		
開発環境	ベンダ各社が提供している ARM 対応 ICE が使用可能		
評価ボード	以下の特長をもつリファレンスプラットフォームを準備しています		
	(1) 車載情報機器向けの周辺回路を搭載し、ユーザシステムの実機検証環境を		
	実現		
	(2) アプリケーションソフト等のソフトウェア開発ツールとして使用可能		
	(3) ユーザによるオリジナル機能の追加が可能		
ソフトウェアプラットフ	対応 OS: Linux、Android <sup>TM</sup> 、QNX® Neutrino® RTOS、Integrity®他		
オーム	OpenGL ES3.1 に対応したグラフィックスライブラリ、OpenMAX IL I/F に対応した H.265、H.264、MPEG-4、VC-1 ビデオコーデックライブラリ、OS 標準の API に対応した BSP を準備しており、トータルシステム へのソフトウェアソリューションを提供します		

- \*ARM、Cortex は、ARM Limited の登録商標または商標です。
- \*PowerVR は、Imagination Technologies Limited の登録商標または商標です。
- \*Android は Google Inc.の登録商標または商標です。
- \*QNX、Neutrino および BlackBerry は、BlackBerry Limited の商標であり、特定の地域で登録および/または使用され、また、QNX Software Systems Limited の許諾のもと使用されます。
- \*Green Hills Software および INTEGRITY は、米国、およびその他の国における Green Hills Software, Inc. の商標または登録商標です。
- \*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する登録証用または商標です。

以上